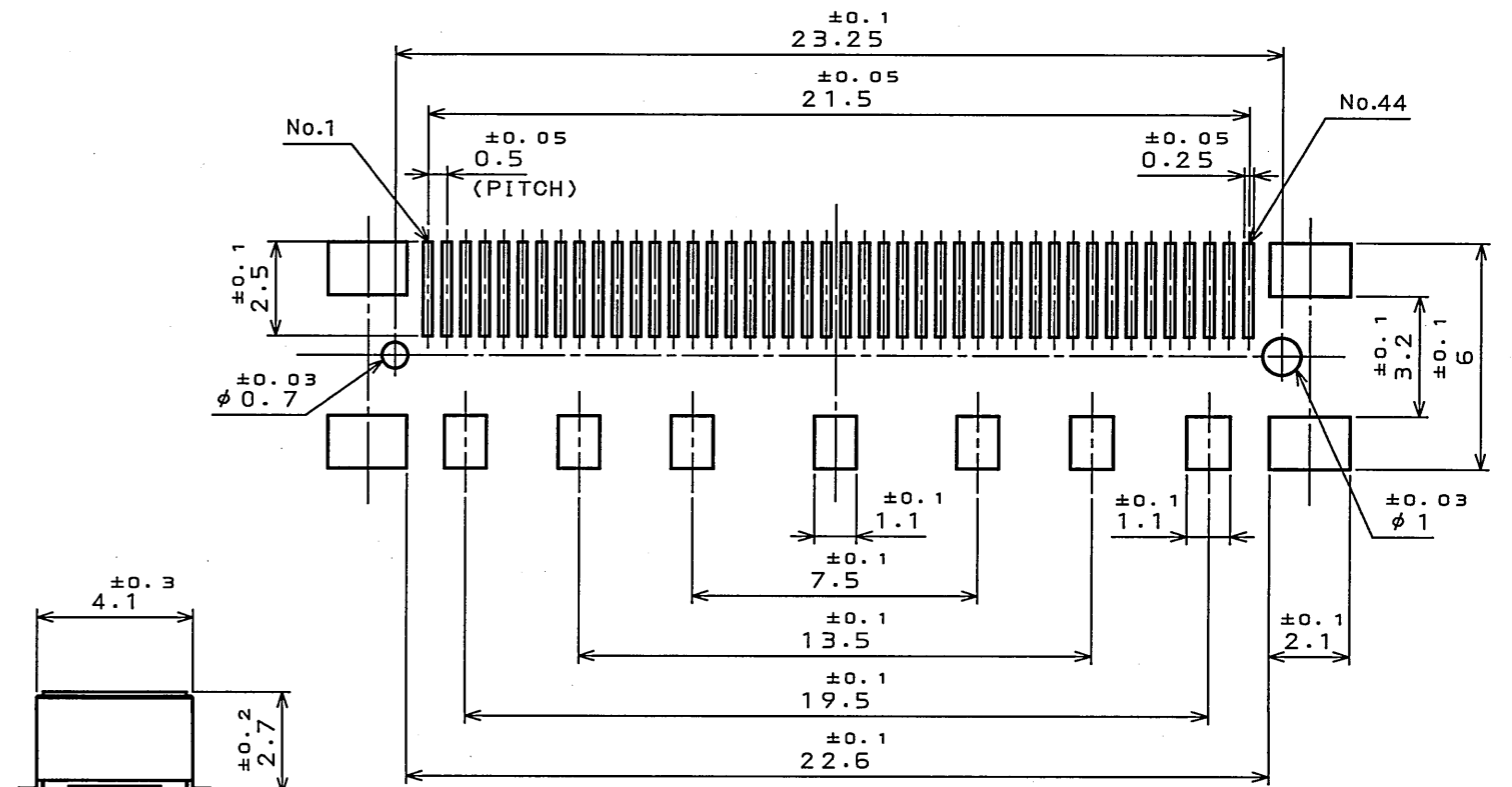
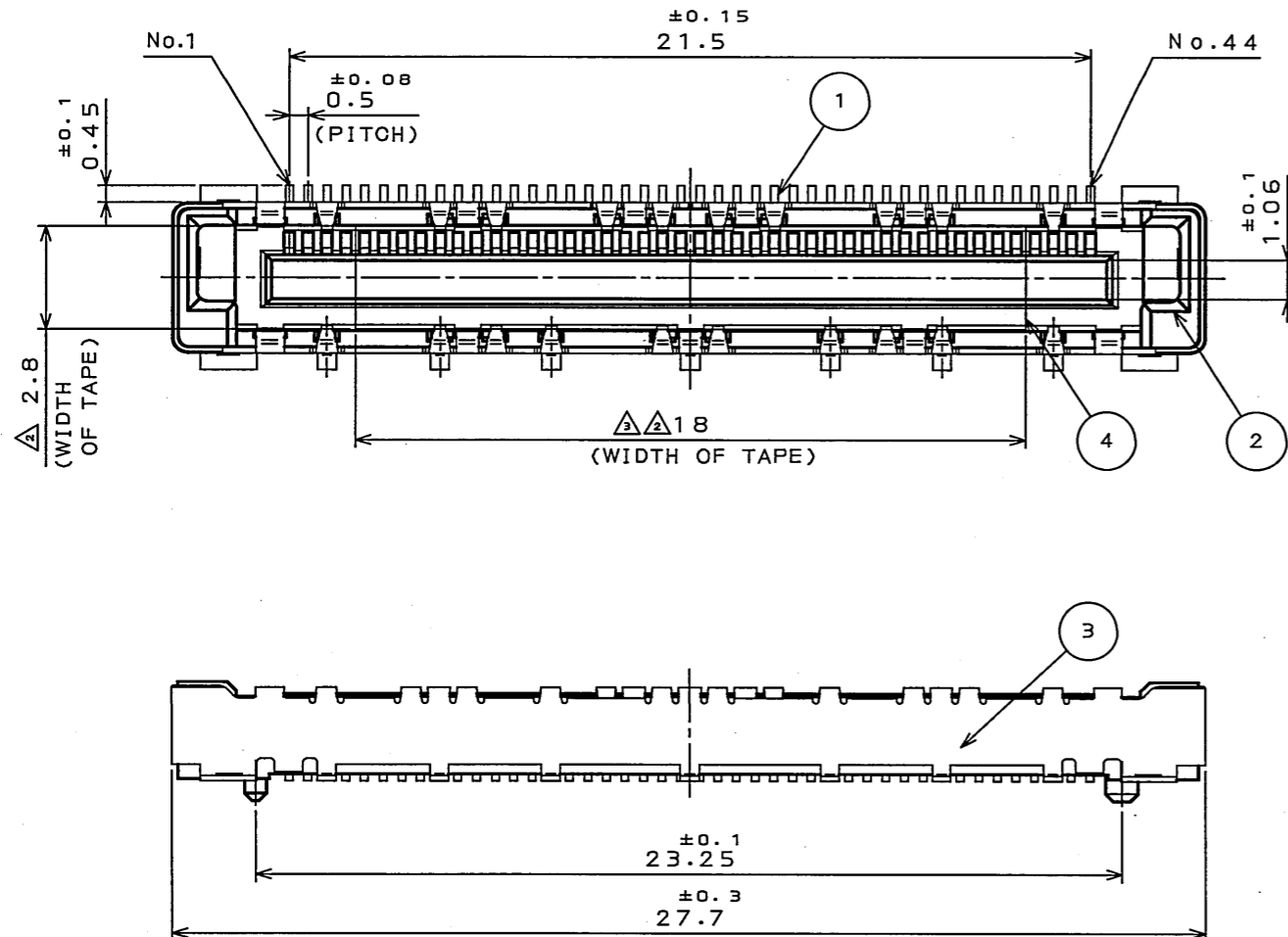


E10101PS

( 'ON ΘNIMVHD)台巻理図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	9.Nov.2005	058652	WIDTH OF ADSORPTION TAPE CHANGE	---	T.YAMAJI	M.SUZUKI	K.HISATOMI
3	13.Dec.2007	064581	WIDTH OF ADSORPTION TAPE CHANGE	---	T.YAMAJI	M.SUZUKI	K.HISATOMI

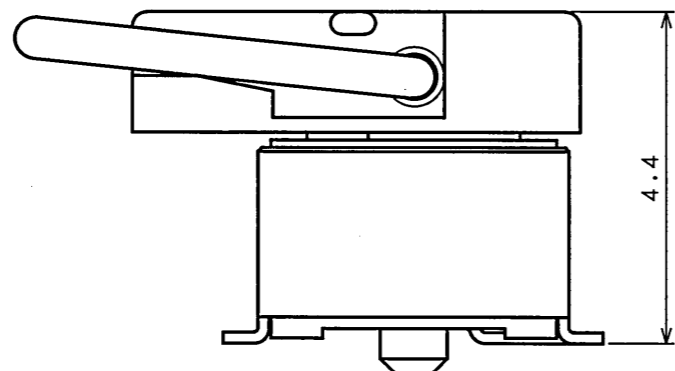


APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)  
適合基板寸法 (参考)

TABLE 1  
表 1

CONTACT AREA 接触部	TERMINAL AREA 端子部
GOLD(MIN.0.76μm) OVER NICKEL Ni上Au(0.76μm以上)	GOLD(MIN.0.03μm) OVER NICKEL Ni上Au(0.03μm以上)

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
4	HEAT RESISTING TAPE 耐热テープ	1	PI		t0.05
3	SHELL シェル	1	COPPER ALLOY 銅合金	TIN PLATING スズメッキ	
2	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐热性プラスチック		UL94V-0 BLACK 黒
1	CONTACT コンタクト	44	COPPER ALLOY 銅合金	SEE TABLE 1 表1参照	



MATED CONDITION (REF.)  
嵌合状態 (参考) (SCALE 10:1)

特別管理品目  
SPECIAL CONTROL ITEM  
DCOM

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)	
		20.May.2004		5:1		FI	
製図 DR.		担当 CHK.		名称 (TITLE)			
		M.KIKUCHI		FI-TD44SB-LE			
公差 (GENERAL TOLERANCE)		査閲 APPD.		質量 (MASS)			
寸法 (DIMENSION)		承認 APPD.					
角度 (ANGLES)		Y.ICHIYAMA					
· ±	×° ±			日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.			
· X ±	· XX ±						
· XXX ±	· XXXX ±						
				図面番号 (DRAWING NO.)		版数 (REV.)	
				SJ101013		3	

DOF-0-212F(05.08)

